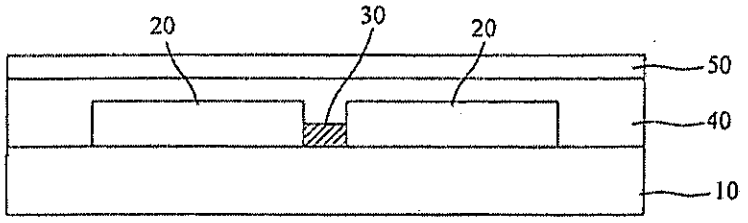
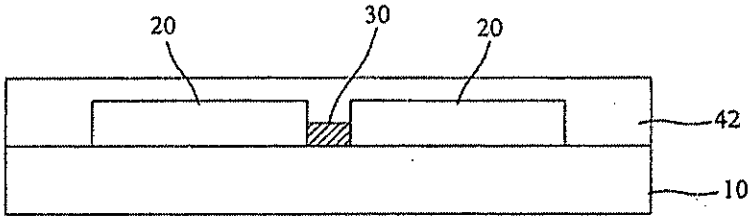
附圖一（系爭專利）：

1. 第一圖係一移除失效型無線射頻辨識電子標籤結構的示意圖。



10：表面層
20 ：印刷天線
30 ：無線射頻晶片(RFIC)
40 ：接著層
50 ：離型層

2. 第二圖係另一實施例移除失效型無線射頻辨識電子標籤結構的示意圖。



10：表面層
20 ：印刷天線
30 ：無線射頻晶片(RFIC)
42 ：接著層

附圖二（被證 1）：

圖 2A、圖 2B 爲一無線射頻辨識標籤自一表面移除前後示意圖，圖 7 爲一無線射頻辨識標籤剖面圖。

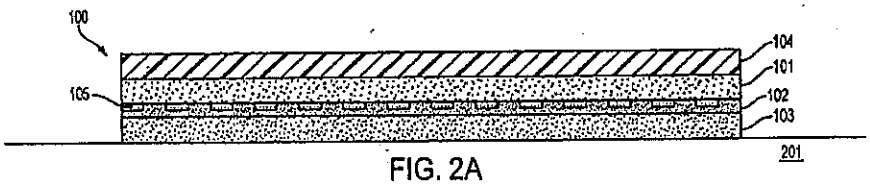


FIG. 2A

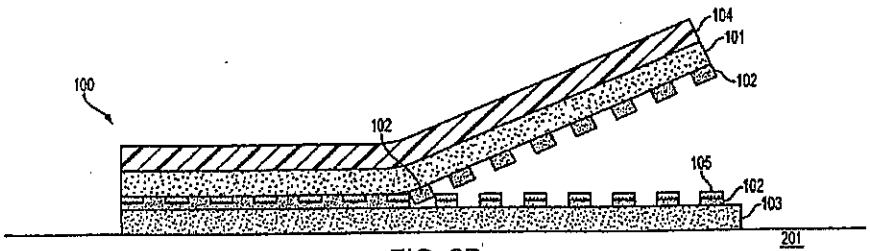


FIG. 2B

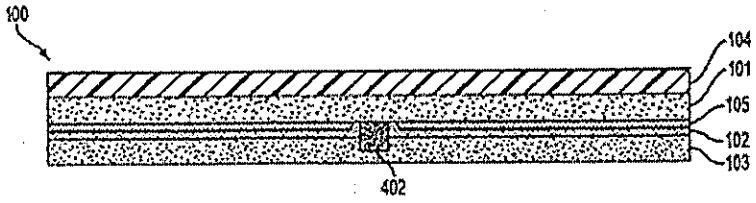


FIG. 7A

101：RFID層
102 ：防偽線路
103 ：接著層
104 ：最外層
105 ：接著強度修正層

附圖三（被證3）：

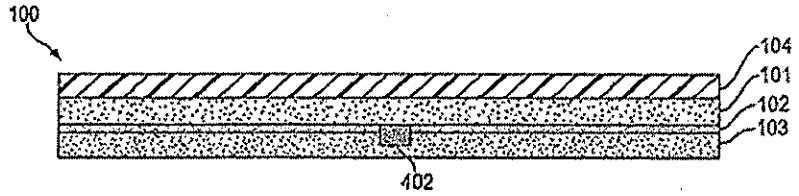


FIG. 7A

101：RFID層
102：防偽線路
103：接著層
104：最外層
402：RFID元件

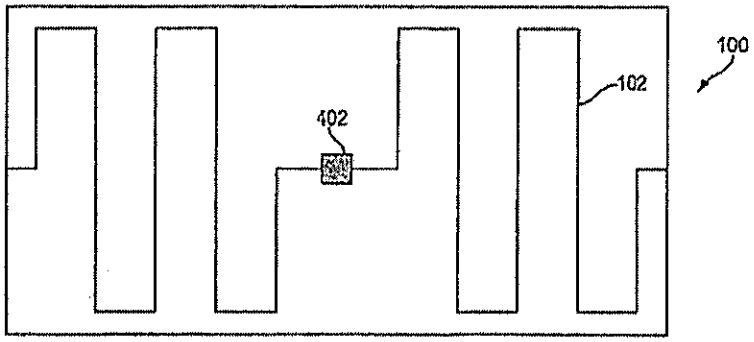
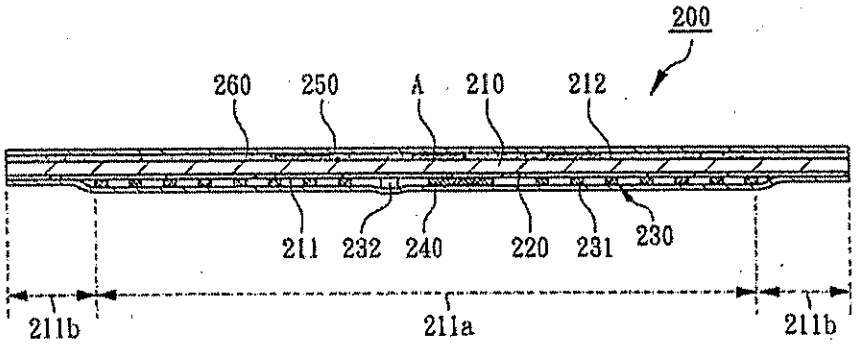


FIG. 7B

附圖四（被證5）：



210：主體層
211：第一表面
220：第一膠層
231：天線
232：晶片
240：第一保護片

第 4 圖